

GUIP 산학협력 전문가 현황

| | | |
|-------------------|-------|----------------------------|
| 플랫폼 현황 | 플랫폼명 | 경기도 반도체 인력양성·기술협력 대학혁신 플랫폼 |
| | 전문 분야 | 반도체PKG/부품 분야 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------|----------------|---|--|
| 산학협력 전문가 정보 | 전문가 정보* | 성함 | 조홍백 교수 | |
| | | 전공 | 한양대학교(석사), 한양대학교(박사) | |
| | | 소속 / 학과 | 공학 대학 / 재료화학공학과 | |
| | | 직위 | 교수 | |
| | | 이메일 | hongbaek@hanyang.ac.kr | |
| | | 연락처 | 010-XXXX-XXXX | |
| | 산학협력 정보 | 전문분야 | 1) 국책사업 수주관련 상담, 2) 기술애로 상담 및 기술자문 | |
| | | 기술개발 지원가능분야 | 1) 방열복합 소재 연구개발, 2) 탄소중립 관련 음이온 흡착소재 연구개발, 3) 가스센서 연구개발 | |
| | | 지식재산권 | 1) KR10-2384105: 방열복합소재 및 그 제조 방법 2) KR10-2645530: 방열 및 전자파 차폐/흡수능을 가지는 다기능성 복합 필름 및 이의 제조방법 3) KR10-2265163: 2차원소재를 이용한 음이온제거 및 그 응용 | |
| | | 기술이전 | 1) 기술명: 열전도성을 갖는 삼차원 구조의 고분자 복합소재 및 그 제조방법; (이전업체) 마이크로컴퍼지트 ㈜; (계약기간) 2019.08.29~2022.08.02. | |
| | 산업체경력** | 기관명 | | |
| | | 담당업무 | | |
| | 창업** | 창업연도 | | |
| | | 회사명 | | |
| | | 분야 | | |

* 해당사업에 참여중인 교수의 정보를 작성 바랍니다.
 ** 산업체경력 및 창업 경험이 있는 분에 한해 작성 바랍니다.
 - 파란색 글씨는 삭제 후 작성 부탁드립니다.